

ATM-1100G

全自動ウェーハ表面保護テープ貼付装置

Full Automatic Wafer Protective Tape Laminating Machine

【概要 - Outline -】

◆本装置は、ウェーハ裏面研磨工程前のウェーハ表面に保護テープを全自動で貼る装置です。
The ATM-1100G is the ideal system for laminating tape to wafers, before the backgrind process.

【特長 - Features -】

- ◆テープのラミネート後、特殊制御カッターによりウェーハの外形寸法に沿ってカットするため、高精度で気泡の無い均一なラミネートを行うことができます。
Special controlled cutting along the wafer contour after tape lamination ensures the production of uniform and high precision taper laminates free from bubbles.
- ◆特殊制御によりノッチ及びあらゆる角度の第2オリフラ付のウェーハにも対応できます。
Special controlled cutting provides notched wafers and all-angle secondary flat positioned wafers.
- ◆ランニングコストの低減が計れます。
Ensures lower running cost.
- ◆テープテンションを与えない為、研削後のウェーハにストレスを与えません。
Without providing tape tension onto wafer, wafer does not have any stress after Back Grinding.
- ◆タッチパネル対応。



仕様 Specification	ATM-1100G	
スループット Throughput	90 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	4・5・6・8 inch	
使用テープ幅 Tape Width	130 ~ 230mm	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC100V 単相 Single phase 50/60Hz 1.5KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.5Mpa 90NI/min
	真空減 Vacuum source	-74Kpa
装置寸法 Demension	W 1,200 × D 1,140 × H 1,645 mm (シグナルタワー除く Excuanding signal tower)	
重量 Weight	約 500kg (Approx 500kg)	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.